

HSON8

HSON8 封装的面积与标准 SOP8 封装相同 (5 x 6 毫米)。HSON8 采用外露式焊盘以优化热性能。

应用

HSON8 适用于中功率应用 (参考值为 80W*/60A)，且专为低导通电阻和高速切换式 MOSFET 而量身定制。特别适用于：

- ▶ 电机驱动器
- ▶ 喷射驱动器
- ▶ 电源电路
- ▶ 指示灯驱动器
- ▶ 汽车应用产品

*壳温 = 25°C，结温 = 最高 150°C

可靠性鉴定

Amkor 封装采用成熟可靠的半导体材料。全部可靠性测试包括：

- ▶ JEDEC 标准预处理，高温存储除外
- ▶ 85°C/85% 相对湿度，168 个小时，IR 回流焊 260°C 3X
- ▶ H³TRB：85°C/85% 相对湿度，1000 个小时
- ▶ uHAST：130°C/85% 相对湿度，96 小时
- ▶ 温度循环 -55°C/+150°C，1000 次循环
- ▶ 高温储存：150°C，1000 个小时

测试服务

Amkor 为全部电源分立器件提供完全一站式的服务，我们有能力测试各种类型的电源器件，包括 MOSFET、智能电源器件，等等。

- ▶ 功率分立测试能力
 - ▷ 直流
 - ▷ 电容 *1
 - ▷ R_g *1
 - ▷ 雪崩耐量测试
 - ▷ 热阻
- ▶ 程序生成
- ▶ 电气故障分析
- ▶ 集成测试、打标、外观检查和卷带式包装服务

*1 仅抽样试验

特色

- ▶ 铝线焊接
- ▶ 从晶圆切割到成品测试与包装的一站式服务
- ▶ 绿色材料：无铅电镀和无卤素模塑化合物
- ▶ 引脚前端电镀厚度超过引脚框架厚度的 50%

正在开发

- ▶ 晶粒贴装采用保护环境的无铅焊膏

工艺亮点

- ▶ 互连：铝线直径 125 微米 ~ 300 微米
- ▶ 电镀：100% 雾锡
- ▶ 打标：激光打标

HSON8

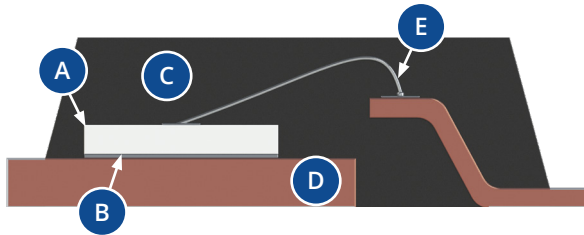
标准材料

- ▶ 引脚框架：铜，焊线区采用镍镀层
- ▶ 晶粒贴装：含铅焊膏
- ▶ 互连：铝线
- ▶ 模塑化合物：无卤素

装运

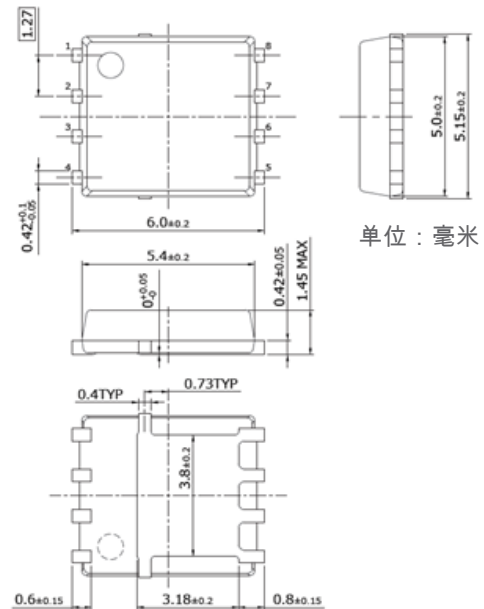
- ▶ 卷带式包装
 - ▷ 每卷 2500 件
 - ▷ 卷带宽度 12 毫米
 - ▷ 每卷直径 = 30 毫米
- ▶ 条形码封装标签

横截面



- A Die
- B Die attach material
- C Mold compound
- D Leadframe
- E Al wire

封装外形图



俯视与仰视图



访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。



关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2020 Amkor Technology, Incorporated. 保留所有权利。DS407D-CN 修改日期：01/20

